



晶圆分选机

SW2000 系列晶圆分选设备支持 6"、8"、12" 晶圆分选、满足多个 Port 之间的高速晶圆互传，根据不同需求可搭配 SEMI 标准的 Foup、Fosb、Open Cassette、Smif Port 等装载单元，同时也可以实现装载单元的混搭配置。设备结构经过特殊设计，最高可以达到 Class1 的洁净度要求。系统可以根据客户要求定制 Fork 形状及拾取方式，Aligner 可选配 OCR 读码功能，确保能够完成稳定、高效的晶圆分选工作。

AUTOMATIC WAFER TRANSFER SYSTEM



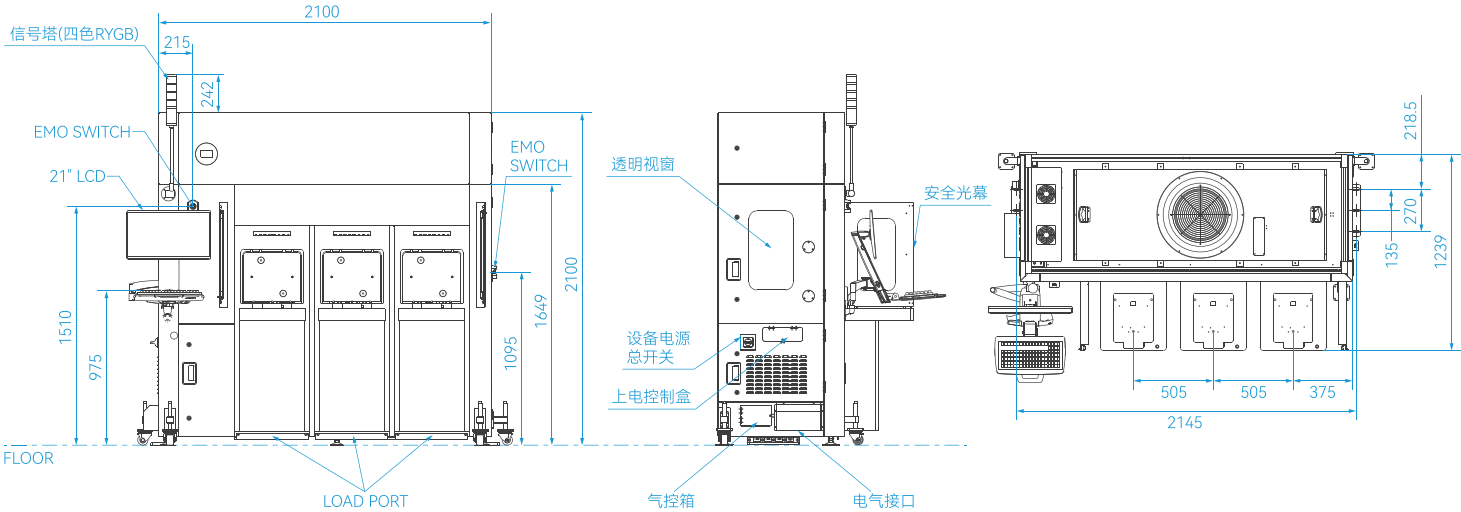
产品特征

- ▶ 兼容150mm/200mm/300mm Wafer
- ▶ 多种取放片方式可选
- ▶ 可读取Wafer上、下面ID
- ▶ OHT、Stocker可对应
- ▶ 可选配边缘检测功能

规格参数

型号	SW2203	SW2303	SW2403	SW2206	SW2306	SW2406	SW2806
Port数量	2	3	4	2	3	4	8
晶圆尺寸	6" - 8"	6" - 8"	6" - 8"	8" - 12"	8" - 12"	8" - 12"	8" - 12"
载体	300mm FOUP 25(SEMI E47.1)						
	300mm FOSB 25(SEMI M31)						
晶圆传输	VTR / STR 系列机械手						
晶圆拾取方式	真空/夹持或其他结构可定制						
晶圆对准	标准晶圆预对准Aligner						
晶圆ID	单面/双面晶圆D专用读码器						
电源电源	单相AC200V~AC220V±10% 50/60Hz±5%						
电流	4kVA(20A/200VAC)包含FFU						
真空（压力）	-80kPa ~ -90kPa						
正压（压力）	0.6MPa ~ 0.7MPa						

设备图纸 (以 SW2306 为例)



星微科技

详细规格参数内容请由此下载:
xivitech.com/downloads/



官网



公众号